

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：張庭軒 助理研究員
電話：02-2737-7437
傳真：--
電子信箱：tschang@nstc.gov.tw

受文者：國立政治大學

發文日期：中華民國112年12月14日
發文字號：科會工字第1120082378號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：本會113年度「前瞻晶片設計軟體技術開發計畫」自即日起接受申請，請於113年2月20日（星期二）前函送本會，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依本會補助專題研究計畫作業要點規定辦理，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱本計畫徵求公告及相關附件各項規定。
- 二、本計畫申請案全面實施線上申請，各類書表請務必至本會網站（<https://www.nstc.gov.tw>）進入「學術研發服務網」製作；計畫類別：「專題類-隨到隨審計畫 | 一般策略專案計畫」，學門代碼：「E9877-前瞻晶片設計軟體技術開發計畫」，子學門代碼依計畫所屬分項點選其中之一「E987701-開發異質整合與先進封裝的EDA、E987702-前瞻製程技術工具開發」，以利識別。
- 三、本計畫未獲補助案件恕不受理申覆。
- 四、檢附計畫徵求公告1份，並公告於本會工程處網站（<http://www.nstc.gov.tw/eng/ch>）。
- 五、計畫徵求說明會資訊：
 - (一) 時間：112年12月29日(五) 上午10點。



(二) 地點：以線上視訊會議方式參與。

(三) 參與方式：視訊參與者請事先報名，會議相關更新資訊及視訊會議網址將於12月27日前e-mail通知，報名網址：<https://forms.gle/QzcZwdJLu2pkSxEe6>。

正本：專題研究計畫受補助單位（共301單位）

副本：本會工程處、綜合規劃處

112/12/15
14:08:56
電子印章